

111 年度經濟部工業局委託正修學校財團法人正修科技大學 「智慧電子人才應用發展推動計畫-正修 IC 封裝與測試設備工程師人才養成班」 招生簡章

經濟部工業局廣告

一、參與單位：

1. 指導單位：經濟部工業局 
 2. 承辦單位：財團法人資訊工業策進會 
 3. 開班單位：正修學校財團法人正修科技大學電子工程系（高雄市鳥松區澄清路 840 號） 
- 連絡人：蔣瑜琳、吳姿儀、林郁婷 電話：07-7358800 轉 3202、2703、2776、3833

二、開課資料：

班別名稱	時數	收費標準	培訓期間	上課時間及地點	上課時數
正修 IC 封裝與 測試設備工程 師人才養成班 (先訓後聘班) (待業者)	203 小時	自繳費用 24,000 元 工業局補助 36,000 元	111/6/27- 111/9/2	時間：每週(一~四) 09:00-16:00 (每日上課 6 小時) 地點：正修科技大學專業教室 ※實際上課時間、課程內容、講師， 執行單位皆保有最後調整權利。	基礎課程：48 小時 核心課程：56 小時 實務課程：96 小時 性別主流化、職場倫理及 就業輔導講座 3 小時

※ 課程費用與獎助優惠辦法：

1. 學員自費 24,000 元，工業局補助 36,000 元整(總學費 60,000 元，工業局補助 60%)。
2. 報名時毋需繳交費用，待正式錄取後再行通知費用繳交時間。
3. 本課程符合申請勞動部產業新尖兵試辦計畫補助，詳細資格請參考勞動部官網。(最多可全額補助自繳費用)

◎備註：『結訓學員應配合經濟部工業局培訓後電訪調查』。

三、主要招生對象：目前待業者，或者對半導體產業有興趣者。

四、報名資格：

1. 大專以上電子、電機、機械、資工等相關科系畢業者尤佳，或其它理工科系畢業及應屆畢業者皆可(無就業意願者，請勿報名)。
2. 大專以上非理工科系畢業，有意願長期從事半導體產業工作者。

五、招生名額：

本班僅招收 20 人，額滿為止；最低開班人數 15 人。

六、報名日期：即日起至 111 年 6 月 24 日止，達 80% 即開班。

報名地點：高雄市鳥松區澄清路 840 號正修科技大學電子工程系系辦公室(週一至週五上午 9:00 至下午 5:00)。
洽詢電話：07-7358800 轉 3202、2703、2776、3833，洽蔣瑜琳、吳姿儀、林郁婷助理。

七、就業輔導：在培訓期間邀請南部封測廠商開辦媒合講座，結訓成績合格者，將協助學員尋找就業機會，結訓後搜尋廠商之就業機會資訊，並將學員名冊推薦給有需求之廠商，進行雙方媒合工作。

八、課程簡介：

編號	課程名稱	上課 時數	實習 時數	合計 時數	課程大綱
1.	基本電學	4	0	4	1.電路元件 2.電路分析 3.電容 4.電感
2.	半導體元件概論	6	0	6	1.半導體材料 2.P-N 二極體 3.MOSFET
3.	IC 封裝製程概論	8	0	8	1.封裝製程之定義與功能 2.封裝技術層次分類 3.封裝技術之種類 4.IC 封裝製作流程
4.	機電整合概論	4	0	4	PLC 技術介紹
5.	品質管制手法	4	0	4	品質管制手法
6.	失效模式與效應分析(FMEA)	4	2	6	FMEA 分析
7.	科技英文	4	0	4	半導體產業專業英文
8.	程式設計	4	2	6	程式語言
9.	測試原理	6	0	6	測試機架構與機制
10.	封(構)裝材料特性	10	0	10	1.封裝材料的熱能 2.封裝材料的機械性 3.封裝材料的電屬性 4.封裝材料的物理性
11.	封(構)裝設備概論	10	0	10	IC 封裝製程設備原理與機制結構
12.	全面生產設備保養(TPM)	6	0	6	全面生產設備保養手法
13.	感測器技術	8	0	8	各式感測器原理與應用
14.	靜電防護理論與實務	4	2	6	1.靜電之基本概念 2.靜電放電產生的災害 3.靜電防護與實務範例操作
15.	PLC 控制與機械自動化應用	4	6	10	1.常用儀表使用與量測(示波器、函數波產生器、數位電表、電源供應器) 2.溫度控制實習(溫度感測器、運算放大器、繼電器) 3.可程式控制器概論 4.階梯圖基本使用方法 5.實作範例操作
16.	先進半導體封裝技術與製程應用	6	0	6	1.封裝產業發展簡介 2.新世代封裝技術 3.SIP 封裝技術 4.3DIC 封裝技術 5.FOWLP
17.	封裝機台操作與實習--研磨	0	4	4	1.Wafer Back Side Grinding-製程及材料介紹 2.Wafer Back Side Grinding-現場 Sample 展示及解說 3.Wafer Back Side Grinding-機台解說及設備問題排除 4.Wafer Back Side Grinding-產線實際觀摩解說
18.	封裝機台操作與實習-De-taping/Wafer Mounting/Film Mountin	0	4	4	1.De-taping/Wafer Mounting/Film Mounting-製程介紹 2.De-taping/Wafer Mounting/Film Mounting-現場 Sample 展示及解說 3.De-taping/Wafer Mounting/Film Mounting-機台解說及設備問題排除 4.De-taping/Wafer Mounting/Film Mounting-產線實際觀摩解說
19.	封裝機台操作與實習—切割	0	4	4	1.Wafer Sawing-製程及材料介紹 2.WaferSawing-現場 Sample 展示及解說 3.Wafer Sawing-機台解說及設備問題排除

					4.Wafer Sawing-產線實際觀摩解說
20.	封裝機台操作與實習--黏晶	0	4	4	1.Die Bonding-製程及材料介紹 2.DieBonding-現場 Sample 展示及解說 3.Die Bonding-機台解說及設備問題排除 4.Die Bonding-產線實際觀摩解說
21.	封裝機台操作與實習--鐳線	0	4	4	1.Wire Bonding-製程及材料介紹 2.Wire Bonding-現場 Sample 展示及解說 3.Wire Bonding-機台解說及設備問題排除 4.Wire Bonding-產線實際觀摩解說
22.	封裝機台操作與實習--ball Mount	0	4	4	1.Ball Mounting-製程介紹 2.Ball Mounting-現場 Sample 展示及解說 3.Ball Mounting-機台解說及設備問題排除 4.Ball Mounting-產線實際觀摩解說
23.	封裝機台操作與實習--封膠	0	4	4	1.Molding-製程介紹 2.Molding-現場 Sample 展示及解說 3.Molding-機台解說及設備問題排除 4.Molding-產線實際觀摩解說
24.	封裝機台操作與實習-Laser Marking	0	4	4	1.Laser Marking-製程介紹 2.Laser Marking-現場 Sample 展示及解說 3.Laser Marking-機台解說及設備問題排除 4.Laser Marking-產線實際觀摩解說
25.	封裝機台操作與實習-Singultion Saw	0	4	4	1.Singultion&Sawing-機台解說及設備問題排除 2.Singultion&Sawing-產線實際觀摩解說 3.Forming/Singulation(彎腳/成型)-產線實際觀摩解說
26.	封裝機台操作與實習-Plasma	0	4	4	1.Plasma-製程介紹 2.Plasma-產線現場操作解說 3.Plasma-機台解說及設備問題排除 4.Plasma-產線實際觀摩解說
27.	封裝機台操作與實習-去膠/去緯	0	4	4	1.Dejunk/Trim(去膠/去緯)-製程介紹 2.Dejunk/Trim(去膠/去緯)-實際觀摩解說 3.Dejunk/Trim(去膠/去緯)-機台解說及設備問題排除 4.Dejunk/Trim(去膠/去緯)-實際觀摩解說
28.	封裝機台操作與實習 -Forming/Singulation	0	4	4	1.Forming/Singulation(彎腳/成型)-製程介紹 2.Forming/Singulation-機台解說及設備問題排除 3.Forming/Singulation-產線實際觀摩解說
29.	探針卡設計與維修實作	0	3	3	1.數位測試實作 2.混合模式測試實作 3.樣品比對實作
30.	記憶體測試之 Tester 設備操作與維修概論	0	3	3	記憶體測試之 Tester 設備操作與維修概論
31.	記憶體測試之 Handler 設備操作與維修概論	0	6	6	記憶體測試之 Handler 設備操作與維修概論
32.	記憶體測試之 Hi Fi (HF)設備操作與維修概論	0	2	2	記憶體測試之 Hi Fi (HF)設備操作與維修概論
33.	記憶體測試之 Oven 設備操作與維修概論	0	2	2	記憶體測試之 Oven 設備操作與維修概論
34.	記憶體測試之 Loader/Unloader(LD/UL) 設備操作與維修概論	0	2	2	記憶體測試之 Loader/Unloader(LD/UL)設備操作與維修概論
35.	記憶體測試之 Change kit 製具設備操作與維修概論	0	2	2	記憶體測試之 Change kit 製具設備操作與維修概論
36.	記憶體測試之 Burn inBoard(BIB)製具設備操作與維修概論	0	2	2	記憶體測試之 Burn in Board(BIB)製具設備操作與維修概論
37.	記憶體測試 Laser Marker 原理與應用	0	2	2	記憶體測試 Laser Marker 原理與應用

38.	記憶體測試之 Lead Scanner 原理與應用	0	2	2	記憶體測試之 Lead Scanner 原理與應用
39.	記憶體測試之 Tape & Reel 捲帶機原理與應用	0	2	2	記憶體測試之 Tape & Reel 捲帶機原理與應用
40.	記憶體之測試程式語言-機台實習及實務操作	0	18	18	1.測試程式語言與機台實習 /樣品比對 2.測試程式語言與機台實習 3.測試程式語言與機台實習
41.	記憶體測試之儀表與量測	0	2	2	記憶體測試之儀表與量測
42.	兩性關係	1	0	1	兩性關係
43.	職場倫理	1	0	1	職場倫理
44.	就業輔導講座	1	0	1	就業輔導講座
合 計		95	108	203	

九、課程師資：

師資陣容最堅強：由正修科技大學專業師資群與具半導體封測與設備實務經驗之學(業)界人士授課。

十、甄選時間：111年6月27日上午10時整至正修科技大學參加面試，通過後繳交課程費用；或者提早報名者可先進行面試。

甄選地點：高雄市鳥松區澄清路840號，正修科技大學電子工程系館2樓會議室(060207)。

◎現場繳交與填寫資料：

- (1)招生簡章的附件一「正修 IC 封裝與測試設備工程師人才養成班」報名表
- (2)「受訓學員訪談表」
- (3)繳交二吋相片1張
- (4)最高學歷畢業證書影本
- (5)身份證影本
- (6)最高學歷在校成績單
- (7)學員基本資料表附個資提供同意書
- (8)其他有利審查資料

洽詢專線：

計畫連絡人:蔣瑜琳、吳姿儀、林郁婷，電話：(07)7358800 轉 3202、2703、2766、3833。

計畫主持人:王納富 教授，電話：(07)7358800 轉 3230、0926063635。

十一、上課地點：基礎與核心課程授課地點正修科技大學電子工程系、實務課程授課地點華東科技股份有限公司。

十二、報到方式與繳費及證件審核：

1. 報到時間：111年06月27日(一) 12:00，於正修科技大學電子系館2樓會議室(060207)辦理報到並當場完成繳費手續。
2. 報到時須攜帶最高學歷畢業證書、最高學歷在校成績單、最近半身2吋相片1張。
3. 簽署個資同意書、學員守則切結書各一份。
4. 報到當天因故無法到達者，請於報到日前一天以電話完成請假(須核對相關資料)。
5. 報到當天未完成報到者或是未請假者，視同放棄錄取資格，其資格由備取者遞補，且不得異議，其所繳交之費用依據“退費標準”辦理。

十三、退費與結訓標準：

- 1.如因故無法開班者，所繳費用全額退還。學員於繳費後上課前退訓者，退還九成之自繳費用；於上課後總時數未逾三分之一(含)退訓者，退還五成之自繳費用；逾總時數三分之一者，不退還任何費用。
- 2.依經濟部工業局規定，學員完成全期訓練，學習成果評量達 60 分以上，出席率達 70%，由工業局核發結訓證書。
- 3.患有精神官能障礙疾病者，雖經考試錄取或已報到註冊，培訓單位必要時得予退訓。
- 4.受訓期間破壞公物或上課秩序，經告誡不聽者，培訓單位必要時得予退訓，並要求賠償。
- 5.受訓期間缺課時數達總訓練時數二分之一(含)者，無論缺課理由為何，不發給結訓證書。
- 6.退訓或訓練成績不合格者，不發給結訓證書。成績不合格係指受訓期間各科考試(含筆試、實習、課程實作與平常成績)成績按各科時數加權計算，總平均低於六十分(不含)者。
- 7.本課程學費經工業局部分補助，上課學員皆需依工業局規定填寫相關資料、於培訓過程中與培訓後做問卷及電訪調查，且學員出席時數需達報名課程之總時數七成以上，且考核成績及格，方可適用工業局之補助。
- 8.參加此培訓課程之學員需配合計畫課程之就業媒合活動及訊後就業調查。

十四、特色：領先南部大專校院之半導體特色實驗室與優良教學環境，師資均有良好實務經驗，辦理各種職業訓練經驗豐富，口碑良好，經培訓後成績合格者，媒合至相關領域就業。

十五、簡章：請至正修科技大學電子工程系辦公室免費索取；或請上網下載：<http://www.ee.csu.edu.tw/>。

十六、注意事項：

1. 若遇有不可測之突發因素，開班單位保有相關課程調整、取消及授課師資之變動權力。
2. 課程嚴禁旁聽、錄影，亦不可攜眷或其它人士參與。
3. 參加培訓課程之學員食、宿需自理。
4. 您已詳閱各注意事項，再進行報名手續，報名即表示同意遵守本開班單位一切規定。



營造友善家庭職場環境 員工工作安穩 企業形象升等 力行家務分擔 家庭和樂升溫

珍視員工價值

性別平等 幸福升等

讓職場員工平等發揮實力、自我實現，各種性別的受雇者均受益。

- ◆ 女性夜間工作安全措施（交通或住宿）
- ◆ 提供員工兼顧工作與家庭之彈性工作時間與地點、休假制度
- ◆ 協助均衡家庭和工作之措施，如托兒設施、哺乳室、育兒津貼規定等。
- ◆ 積極僱用因結婚、懷孕、分娩、育兒或照顧家庭而離職之二度就業者
- ◆ 積極拔擢女性擔任主管、積極僱用身心障礙及原住民
- ◆ 鼓勵企業僱用中高齡勞工，避免及早退休
- ◆ 鼓勵男性做家事

員工協助方案(EAP)

讓員工在工作與家庭間取得平衡，提升員工生產力，組織整體受益，員工與企業「雙贏」。

工作面

- ◆ 增進員工對工作之適應、職位轉換、職涯發展、退休規劃及危機處理之輔導
- ◆ 留住優秀的員工、減少員工後顧之憂

生活面

- ◆ 提供員工有關財務、法律、稅務、繼承、交通事故、醫療糾紛等之資訊與知識
- ◆ 避免員工因法律糾紛帶來的心理與生活干擾

健康面

- ◆ 提供員工情緒管理訓練、適當的身心健康管理方案、心理諮詢服務
- ◆ 穩定員工工作情緒、紓解工作壓力、減少離職率、曠職率